



石墨烯散热膜

石墨烯散热膜是由单层形态石墨烯片经过高定向组装形成的连续石墨烯膜，具有高导热系数、高密度和高散热流量的特点，可应用于高功率或者局部高热流密度的电子产品均热和散热，降低电子产品内部局部温度，改善电子产品外壳的散热流量。厚度可定制：10~300 mm，热导率高： $\geq 1000 \text{ W/m} \cdot \text{K}$ （是纯铜的 2.5 倍以上，是纯铝的 3 倍以上），柔性薄膜（可反复弯折），容易加工。

技术参数

厚度	065 (um) $\pm 10\%$	100 (um) $\pm 10\%$	150 (um) $\pm 10\%$	200 (um) $\pm 10\%$
热导率 (W/m·K)	≥ 1100	≥ 1100	≥ 1050	≥ 1000
	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1250	≥ 1200
	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1350	≥ 1300
电导率 (S/cm)	≥ 6500	≥ 6500	≥ 6300	≥ 6000
	≥ 8000	≥ 8000	≥ 7500	≥ 7050
	≥ 9550	≥ 9000	≥ 8000	≥ 7800
抗拉强度 (MPa)	≥ 20	≥ 20	≥ 16	≥ 13
	≥ 25	≥ 23	≥ 20	≥ 15
	≥ 30	≥ 26	≥ 25	≥ 20
原膜耐温性	0~400°C			

应用于手机、平板、笔记本电脑、高功率 PCB 板等电子产品发热元件的均热和散热。

Nanjing JCNano Technology Co., Ltd
Add: Nnijing Road Jianning No. 241 Room 703
Tel: +86 25 58830538, 400-025-7300
www.jcno.net

Zip: 210015



石墨烯铜复合膜

石墨烯铜复合膜是高导热石墨烯膜与铜箔复合形成的一种导热膜材，具有高热导率、低密度、高可靠性、耐高温、耐老化等特点，可以模切加工成复杂形状，也可以做弯折加工，可用于特殊场景的均热和散热。热导率高：是纯铜的 2.5 倍以上；密度低：是纯铜的 50%左右；可靠性高：耐老化、耐高温。

技术参数

石墨烯膜厚度 (um)	100±10%
水平热导率 (W/m·K)	>1100
水垂直热导率 (W/m·K)	>15
电导率 (S/cm)	>150000
抗拉强度 (MPa)	> 80
剥离力 (N/mm)	>6.0
密度 (g/cm ³)	~4.90
耐温性	-100~400℃
阻燃等级	V-0

应用于高功率芯片屏蔽均热一体化防护罩、航天器均热、高温环境电子器件均热等领域。

Nanjing JCNano Technology Co., Ltd
Add: Nanjing Road Jianning No. 241 Room 703
Tel: +86 25 58830538, 400-025-7300
www.jcno.net

Zip: 210015